

FIB 技術先進システム分科会 第 1 回研究会
2026 年 7 月 2 日 (木曜日) エッサム神田 2 号館 301 会議室
参加費 ; 3,000 円 (会員), 6,000 円 (個人として非会員) 【Forms 参加申込】

『FIB 加工で作製する TEM 試料の品質と新分科会の設立』

【受付】 12:30~13:00 エッサム神田 2 号館 3 階 301 会議室入口付近

【座長】 原 徹 (NIMS)

13:00~13:15 FIB 研究部会から FIB 分科会として目指す新展開 (新幹事の紹介含む)
大阪大学 杉山 昌章

13:15~13:45 金属からセラミックス材料へ TEM 試料調製の視点からみた FIB 技術
JFCC 加藤 丈晴

14:45~14:15 半導体 Si のダメージ層評価の RRT 結果と金属に導入される格子欠陥
日本製鉄 (株) 先端技術研究所 網野 岳文

14:15~15:45 収束電子回折法を用いた半導体 Si 深部における結晶性低下層の評価
東北大学 多元物質科学研究所 森川 大輔

14:45~15:00 休 憩 (with Coffee Pot Service)

【座長】 金子賢治 (九州大学)

15:00~15:30 化合物半導体やデバイス界面の FIB 加工ダメージ層と除去技術
古河電工 (株) 解析技術センター 佐々木 宏和

15:30~16:00 炭素質地球外物質試料加工への FIB 技術の応用と課題
東北大学 理学研究科 松本 恵

16:00~16:25 FIB-SEM 装置のイオンビームアライメント評価方法検討と RRT の推進
日本電子 (株) 野久尾 毅

16:25~16:30 休 憩

【座長】 加藤 丈晴 (JFCC)

16:30~17:00 <幹事企業枠：サーモフィッシャーサイエンティフィック>
断面作製だけに留まらない！ FIB/SEM 複合機の現状と最新アプリケーション紹介
サーモフィッシャーサイエンティフィック 完山 正林

【意見交換会】

17:45~19:45 会場：KABEAT (神田駅から地下鉄移動。東京駅より徒歩 15 分)
<https://kabeat.jp/> 神田会議室からの移動方法は当日受付で配布。